

ともに歩む、その先の革新へ



イビデン株式会社

第 173 回定時株主総会

2026 年 6 月 19 日(金)

第 173 回定時株主総会 質疑応答要旨

2026 年 6 月 19 日(金)に開催した当社第 173 回定時株主総会において、株主の皆様からいただいたご質問(事前質問・会場質問)とその回答を要約したものです。なお、理解促進のため、一部内容を加筆修正しております。

<1 中東情勢・米国関税の影響について(事前質問)>

- [Q] 中東情勢の変化に伴うエネルギー価格の上昇やサプライチェーンへの影響を危惧している。現時点で当社事業へのリスクをどのように認識しているか？
同様に、2027 年 3 月期は営業利益 900 億円の業績予想であるが、この数値は、中東情勢や米国関税政策の影響をどの程度織り込んだものか？
- [A] 中東情勢や米国関税政策の当社業績予想の影響は、業績予想作成時点での状況が極めて不透明な中で、影響の範囲が特定できないことや、影響を定量的に織り込むことが困難であったため、業績予想に織り込んでいません。また、当社事業に関して特定できた範囲での影響は軽微と見込んでおり、生産を含めて影響はないと認識しています。なお、足もとでは事態は収束に向かっていますが、引き続き、緊張感を持って推移を見守ります。

<2 株主還元の方針について(事前質問)>

- [Q] 今後の株主還元施策について教えてほしい。(増配予定、配当性向の向上、自己株式取得など)
- [A] [交付書面の 28 頁](#)に記載のとおり、キャッシュアロケーションとしては、成長投資を中心に資金を充当していきますが、株主の皆様への利益還元のうち、配当については、2030 年度まで、配当性向 20%を目安とし、累進配当とする方針です。
なお、2026 年度の通期配当予想額は、前年度対比で 5 円増配となる 1 株当たり 35 円(中間 15 円・期末 20 円)を予定しています。株主還元策の選択については、収益水準・財務指標・株価を総合的に判断して実施していきます。

<3 株式再分割の可能性について(事前質問)>

- [Q] 本年 1 月の株式分割後も、当社の株価は大きく上昇しているが、株式再分割の予定はあるか？
- [A] 当社は、投資単位の引下げが、投資家層の拡大及び流動性の向上を図るための有効な施策であると認識しています。当社株式の流動性や株価、株主構成、費用対効果等を総合的に勘案し、引き続き検討していきます。

<4 監査等委員会の実効性について(事前質問)>

- [Q] [交付書面省略事項](#)に監査等委員会の補助使用人設置なし、とあるが、監査等委員会の監査の実効性をどのように確保しているのか？
- [A] 当社は、監査等委員会の監査において、十分な情報が迅速に入手できることや、内部監査部門や会計監査人との強い連携が維持できる環境を、積極的に整備し、支援することで、監査の実効性を確保しています。なお、監査等委員会の補助使用人設置については、監査等委員会の要請があり次第、直ちに設置可能な体制を従前より整えています。

<5 電子事業設備投資の進捗と競争優位性・需要変動リスクについて(事前質問)>

- [Q] 電子事業では 2026~2028 年度で約 5,000 億円の投資を計画しているが、現時点で顧客需要や受注

状況は想定どおり推移しているのか？ 台湾や韓国のメーカーとの競争が激しくなる中で、今後5年から10年維持できる競争優位性は何か？ また、生成AI需要が想定を下回った場合の対応策は考えているか？

- [A] 現時点で顧客需要や受注状況は想定通り推移しています。最先端ICパッケージ基板に対するデマンドは非常に強く、現在の当社のキャパシティでは対応できないほどです。2026～2028年度で5,000億円の投資をしっかりとやり切ることで、ハイエンド市場でのトップシェアを維持していく考えです。

競争優位性については、当社はお客様との長年の信頼関係のもと、中長期の技術ロードマップをいち早く共有いただける立場にあり、競合他社に先行して要素技術の開発に取り組むことができます。その結果、当社は競合他社と比べて実装歩留りの高い、伝送特性の優れた基板を安定して供給できることが強みであると考えています。

また、生成AI需要の下振れリスクについては、最近ではCPUやスイッチICの需要も強くなってきており、仮に需要構造が変化した場合でも、新たな成長市場に確実に対応できると考えています。さらに、変化が大きい電子事業のみならず、安定収益を見込めるセラミックやその他事業の拡大・強化を図ることや、産学官連携などの研究開発活動により、新製品の早期事業化を着実に行うことで、リスク最小化に取り組んでいます。

<6 電子事業設備投資計画の将来展望について>

- [Q] 総額5,000億円の設備投資計画について、現在の生成AI需要の強さを踏まえ、さらなる将来の設備投資計画や、メディアで報じられている「セル7」といった工場ナンバリングの背景について説明してほしい。
- [A] 現在計画中の5,000億円の設備投資は、お客様との協議や契約に基づき決定したものです。生成AI関連の需要は当社の現在の生産能力を大幅に上回る強い状況が続いており、能力増強は必須であると認識しています。現時点でこの5,000億円を超える追加の設備投資は決定していませんが、今後の需要動向を見極めながら検討・計画を進めていきます。工場のナンバリングについては、河間工場(セル6)および大野工場(セル8)の隣接地に、それぞれ将来の増設に備えた用地を確保しています。河間工場隣接地が建設候補となる工場を「セル7」、大野工場隣接地が建設候補となる工場を「セル9」と呼称する予定であり、「セル7」は現時点で欠番になっていますが、今後の需要やお客様との協議に応じて建設を検討する方針です。

<7 設備投資における人材確保とその他の課題について>

- [Q] 総額5,000億円の設備投資に関して、「人材確保等」の問題・リスクについて、「等」が指す具体的な内容と、これらの問題解決の見込みについて、現在の状況を説明してほしい。
- [A] 開示済みの5,000億円の設備投資については、プロジェクト推進および生産能力増強に必要な人材の確保が最も大きな課題と認識しています。現時点では5,000億円規模の投資に必要な人員は確保できていますが、採用活動は厳しい状況にあり、加えて、新規採用者に対する教育も重要な課題です。当社人事部が中心となり解決に向けた取組みを継続的に進めています。

<8 AIサーバー向けICパッケージ基板の技術ロードマップについて>

- [Q] 大型化するAI向けICパッケージ基板において、現在の主流であるシリコンインターポザーを介在させる2.5Dパッケージ以外の技術など、技術開発のロードマップはどのようなになっているのか、当社の開発状況と対応方針について説明してほしい。
- [A] 現在主流のパッケージ構造は、半導体チップと当社製パッケージ基板の間にインターポザーを

設ける三段構造です。このインターポーザーのサイズが限界に近づいているとの認識のもと、当社は、これに代わる複数のオプションを準備しています。具体的には、インターポーザーをより薄くパネル状に形成する材料技術、またはインターポーザーに形成される微細配線をパッケージ基板側に取り込む技術(シリコンブリッジ型などが該当)などです。当社は、将来的にどちらの技術が主流となっても対応できるよう準備を進めており、シリコンブリッジ型の技術については河間工場、その他の技術については大野工場に対応できるよう体制を整えています。

<9 TSMC 社の熊本進出と当社事業との関連性について>

- [Q] TSMC 社が熊本県に新たな工場建設を進めているが、同社の進出が当社の事業にとって有利に働くのかどうか説明してほしい。
- [A] 現時点で当社のパッケージ基板が同社熊本工場において直接採用される状況ではありません。将来における同工場と当社事業との関連性は回答できませんが、一般論として最終的な関係性は、製造された半導体チップの実装拠点がどこに置かれるかで変わります。実装拠点が台湾であれば当社はパッケージ基板を台湾へ出荷することになりますし、日本国内に実装工場が建設される場合はそこに出荷することになります。すなわち、実装拠点の決定が当社事業との関連性における重要な要素となります。

<10 地域貢献活動とスポーツ振興への支援について>

- [Q] 岐阜県揖斐郡におけるスポーツ振興の現状と、他の地域との格差について問題提起するとともに、当社のような大規模企業に地域貢献活動としてスポーツ振興への支援を検討してほしい。
- [A] 当社は地域貢献活動として、2008 年から「イビデンの森」と称する森林保護活動に取り組んでおり、これまでに延べ 4,800 名以上が参加しています。また、次世代育成として工場見学や水力発電所見学なども実施しています。スポーツ振興に関しては、当社の女子 9 人制バレーボールチーム「イビデンレグルス」を通じたママさんバレーとの連携や小学生向けバレーボール教室の開催、地域でのサッカー大会やグラウンドゴルフ大会の支援などを行っており、今後も引き続き、地域社会への貢献活動を推進する考えです。

以上